Informations de base

2013/2905(DEA) DEA - Procédure d'acte délégué	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur
Exemption pour le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits imprimés, les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et les revêtements des cartes de circuits imprimés, les soudures de raccordement des fils et des câbles et les soudures de raccordement des transducteurs et des capteurs qui sont utilisés durablement à une température inférieure à – 20 °C Complétant 2008/0240(COD) **Subject** 3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique 3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)	

Evénements clés

Date	Evénement	Référence	Résumé
18/10/2013	Publication du document de base non-législatif	C(2013)06798	
18/10/2013	Période initiale pour l'examen de l'acte délégué 2 mois		
23/10/2013	Annonce en plénière de la saisine de la commission		
19/12/2013	Pas d'opposition à l'acte délégué par le Conseil		
07/01/2014	Pas d'opposition à l'acte délégué par le Parlement		